### Integral heat pipe, heat exchanger, and clamping plate

Publication number: JP5264182 Publication date: 1993-10-12

Inventor: Applicant: Classification:

-international: F28D15/02; H01L23/427; F28D15/02; H01L23/34; (IPC1-7): F28D15/02: H01L23/427

- european: F28D15/02M; F28D15/02N; H01L23/427

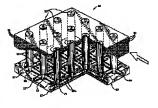
Application number: JP19930020853 19930114 Priority number(s): US19920820566 19920114 Also published as:

W US5253702 (A1)

Report a data error here

#### Abstract of JP5264182

PURPOSE: To drastically improve the heat transfer performance of a substrate by a method, wherein a substrate, provided with a plurality of passages extending in the axial direction as well as the horizontal direction and intersecting mutually, is provided with a plurality of condensing pipes, communicated with respective passages and established substantially vertically to constitute a heat pipe assembly. CONSTITUTION: A heat pipe assembly, annexed to an information processing device and the like, is provided with a substrate 25, provided with a plurality of passages 27, 28, extended in widthwise direction and horizontal direction, while being intersected with each other and provided with a sintered wick in respective internal surfaces of the same, while a plurality of condenser tubes 30 are established substantially vertically on the surface of the substrate. Respective condensing tubes 30 are mounted so that their internal passages 29 communicate with the intersecting position of the passages 27, 28 and are provided with a multitude of sheets of fins 32, extending horizontally on the outer peripheries of the condensing tubes 30 and fixed to the condensing tubes. In this case, a heat pipe assembly in an area, not including the passages 27-29 of the base plate 25 or a structural reinforcing member 35, is attached directly to a heat generating body to aim at the heat radiation of the heat generating body.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出顧公開番号 特開平5-264182

(43)公開日 平成5年(1993)10月12日

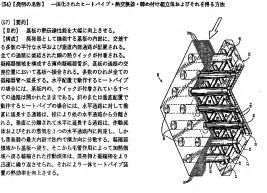
(51)Int.Cl.*	識別配号 庁内整理番号	FI	技術表示箇所
F 2 8 D 15/02	L		
11 0 1 1 22/402			

H 0 1 L 23/46

		番金請水 未請水 請求項の数3(全 7 貝)
(21)出順番号	特顕平5-20853	(71)出順人 591064003 サン・マイクロシステムズ・インコーポレ
(22)出順日	平成5年(1993)1月14日	ーテッド SUN MICROSYSTEMS, IN
(31)優先権主張番号	820, 566	CORPORATED
(32)優先日	1992年1月14日	アメリカ合衆国 94043 カリフォルニア
(33)優先権主要国	米国 (US)	州・マウンテンピュー・ガルシア アヴェ ニュウ・2550
		(72)発明者 ハワード・エル・デビッドソン
		アメリカ合衆園 94070 カリフォルニア 州・サン カルロス・クラブ ドライブ・ 59
		(74)代理人 弁理士 山川 政樹
		最終頁に続く

#### (57)【要約】

【目的】 基板の熱伝達性能を大幅に向上させる。 【構成】 蒸発器として機能する基板の内部に、交差す る多数の平行な水平および垂直内部通路が配置される。 全ての通路に焼結された銅の熱ウイックが付着される。 凝縮器領域を構成する薄肉凝縮器管が、基板の通路の交 差位置において基板へ接合される。 多数のひれが全ての 凝縮器管へ延長する。水平配置で動作するヒートパイプ の場合には、基板内の、ウイックが付着されているすべ ての通路は開かれたままである。斜めまたは垂直配置で 動作するヒートパイプの場合には、水平通路に対して垂 直に延長する通路は、栓により他の水平通路から分離さ れる。垂直に分離されて水平に延長する通路は、作動流 体およびそれの蒸気を1つの水平通路内に拘束し、しか も蒸発器の最大内部寸法内で横方向に分散する。凝縮器 領域から基板へ戻り、そこから毛管作用によって加熱領 城へ戻る疑縮された作動流体は、蒸発相と凝縮相をより 迅速に繰り返させられ、それにより一体ヒートパイプ装 置の熱効率を向上させる。



#### 【特許請求の節囲】

【請求項1】 作動流体を含む第1及び第2の複数のウ イックを張られた通路を備える蒸発器と、

基発した作動液体を経緯させるために前記基発器へ結合

この凝縮器により吸収された熱を移動させるために前記 凝縮器へ結合される熱交換器と、を備え、前記第1の複 数のウイックを張られた通路は前記蒸発器の内部を通っ て第1の向きへ延長し、

前記第2の複数のウイックを張られた通路は前記蒸発器 10 がその熱を周囲の空気すなわち対流空気へ移動させる。 の内部を通って、前記第1の向きに対してほぼ垂直か第 2の向きへ延長する、一体化されたヒートパイプ・熱交 機器・締め付け組立体。

「請求項2」 作動液体を含む祭1、第2及び第3のそ れぞれ複数のウイックを張られた通路を備える蒸発器

この蒸発器のねじれ剛性と曲げスチフネスを高くするた めに前記蒸萃器へ連結された複数の構造補強材と、 前記蒸発器から垂直に延長し、蒸発した作動流体を凝縮 させるために前記蒸発器へ密封させられた複数の細長い 20 薄肉管と、

それらの細長い薄肉管へ熟結合させられ、前記複数の細 長い薄肉管により吸収された熱を移動させる複数のひれ と、を備え、前記第1の複数のウイックを張られた通路 は前別蒸祭器の内部を通って第1の向きへ延長し、

前記第2の複数のウイックを張られた通路は前記蒸発器 の内部を通って、前記第1の向きに対してほぼ垂直な第 2の向きへ延長し、

前記第3の複数のウイックを導られた通路は前記第1の へ横方向に延長し、前記第1の複数の通路と前記第2の 複数の通路が交差する場所において前記第1の複数の通 路と前配第2の複数の通路と交差する、一体化されたヒ ートパイプ・熱交換器・締め付け組立体。

【請求項3】 作動液体を含む第1及び第2の複数のウ イックを張られた通路を備える蒸発器を用意する過程

蒸発した作動流体を軽縮させるために前記蒸発器へ軽縮 器を結合する過程と、

斯緒器へ熱交換器を結合する過程と、を備え、前記第1 の複数のウイックを張られた通路は前記蒸発器の内部を 通って第1の向きへ延長し、

前記第2の複数のウイックを張られた通路は前記蒸発器 の内部を涌って、前別第1の向きに対してほぼ垂直な第 2の向きへ延長する、一体化されたヒートパイプ・熱交 **梅器・締め付け組立体を得る方法。** 

【発明の詳細な説明】

[0001]

であり、更に詳しく言えば、電子的計装装置およびコン ピュータ装置に使用する熱伝達装備に関するものであ

#### [00002]

【従来の技術】電子回路素子を含む熱発生装置は、装置 の動作中に発熱部品により発生された熱を除去するため の熱発散要素を一般に必要とする。ひれを並べたものそ の他の表面積拡張部材を有する放熱器が発熱物体へ密着 され、放熱器の熱質量が熱を発熱物体から除去し、ひれ

更に詳しくいえば、商業用および工業用の熱伝達応用、 とくに狭い物理的空間すなわち限られた物理的空間内で 効率的な熱伝達を行わなければならない場合、または液 冷技術が実際的でない場合に、 ヒートパイプ技術が共々 普及するようになってきた。少なくとも20年前から知 られており、1940年代に行われた研究を基にしてい るヒートパイプは、つい最近商業用および工業用に一般 的に応用されるようになった。ヒートパイプというの は、本質的には、内部が排気されて、少量の不活性作動 流体が注入されて密封された、銅のような熱伝導物質で

製作された中空の薄肉物体である。ヒートパイプに接触 させられている発熱体からヒートバイプの表面が熱を窒 うと、そのヒートパイプはその熱を密封されている作動 流体へ伝える。そうするとその作動流体は局部的に沸騰 し、その結果として発生された蒸気が、加熱されている 領域からヒートパイプ内部の通路を通って冷却領域へ急 速に動き、その冷却領域において作動流体は凝縮させら れる。その凝縮された作動流体は、ヒートパイプの内面 に付着されている勢ウイックの手管作用により加熱領域 向きと前記第2の向きとに対してほぼ垂直な第3の向き 30 へ戻る。ヒートパイプの基本的な特徴は、発熱体に接触 しているヒートパイプの外面全体を、妥当なパワー密度 に対して1℃以内に維持できることである。ヒートパイ プの等温特性は、固体装置の接合温度を比較的狭い温度 範囲に維持せねばならず、かつ1つの同路モジュールに おけるチップの間の湿度差が大きく変化してはならない ような、脳体計装電子装置または固体情報処理電子装置 にとっては特に興味がある。

【0003】ヒートパイプはコンピュータ部品および重 子装置部品を冷却するために従来用いられているが、ヒ この凝縮器により吸収された熱を移動させるために前記 40 - トパイプ自体の物理的制約のために、特定の動作環境 へのヒートパイプの応用は限定されていた。たとえば、 ヒートパイプの要素は通常薄い金属材料で製造されてい るから、ヒートパイプ要素自体の構造的な強度はほとん ど無い。したがって、ヒートパイプは丈夫な基板へ取り 付けられ、その基板を冷却すべき物体へ密着するように 取り付ける。基板はヒートパイプ装置の構造的な強度を 特たせることに加えて、加熱された物体から熱をヒート パイプへ伝えるための放熱機能も果たす。電子装置およ び半導体希却用のヒートパイプの代表的な例には、英国 【産業上の利用分野】本発明は勢伝達装置に関するもの 50 ランカスター州 エデン・ロード (Eden Ros

d) 780. PA 17601所在のサーモコア社(T hermocore Incorporated) EL り製造されているものが含まれる。

【0004】最近、1991年4月に出版されたコーネ ル大学技術報告E-91-06所載の「高熱東マルチチ ップ・モジュール冷却用ヒートパイプ」と難するノース およびアベディジアンの論文に、基板へ連結されている ヒートパイプ要素の間に多数の流路を有するマニホルド として構成されている基板が、従来の基板よりも優れた アベディジアンのヒートパイプが図1に示されている。 図1を参照すると、ノースおよびアペディジアンは、毎 縮器要素6へ連結されたウイックを張られている穴8の 3本並列のセットを含む基板2が適度な表面温度(10 0°C以下)を保ちながら、高い熱東 (20W/cm²) お よび高い総パワー (800W以上)を消費できることを 報告している。そのヒートパイプは表面と冷却空気の間 の進度差が約30℃である環境において動作する。重要 なことは、上記論文において、ノースおよびアベディジ 基板の組合わせは大きい物理的寸法によって高い熱東お よび高いパワー発散を達成している。したがってヒート パイプ装置を小型の計装電子装置または小型の情報処理 装備のためには一般に不適当にしていることである。

【0005】ノースおよびアベディジアンにより開発さ れ、報告されたヒートパイプ組立体は従来のヒートパイ プの構成を改良したものであるが、報告された構造は、 従来のヒートバイプが遭遇していた2つの制約を依然と してこうむっている。最初の制約は高い熱束および高い 総パワー発散が、ヒートパイプ要素へ熟を伝える広いべ 30 て、縦縞器領域から基板へ戻り、そこから作動流体の毛 ース板表面積を有することにより、一般に達成されるこ とである。あるいは、 熱は強い壁を通じて、 基板内に直 接含まれている作動流体へ伝えられ、蒸発させられ、前 記跡縮器で疑縮させられる。ノースおよびアペディジア ンの通路構成は、作動流体を局部的に蒸発させることが でき、かつ後でヒートパイプ凝縮領域において凝縮でき るように、基板に通路を設けて、基板を蒸発器領域とし て構成することにより従来技術を改良するものである。 しかし、多数のヒートパイプ要素により形成されている が設けられていないから、この構成はそれ自身で限定し ている。更に、ノースおよびアベディジアンの構成で は、基板を水平にした場合を除き、ヒートパイプ装置は 任意の向きでは動作しない。その理由は、凝縮された作 動流体の流れが重力により蒸発器領域へ戻り、そこから ウイックを張られている穴へ戻されるためである。 [0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、基板の蒸発 器領域内の蒸発させられた作動流体の移動度を高くする である。また、本発明はヒートパイプ組立体は水平また は垂直位置のいずれでも最適に動作できるようにする。 [0007]

【課題を解決するための手段】この明細書ではヒートパ イブの熱伝達効率を向上させ、かつ熱容量を増大させる 方法および装置を開示する。蒸発器として動作させる基 板には、縦方向および横方向に基板を横切って延長する 平行な通路と垂直な通路がいくつか、穴側け加工その他 の手段により形成される。すべての通路には従来技術に

性能を発揮できることが示唆されている。ノースおよび 10 おけるようにウイックが張られる。凝縮器領域を形成す る二重壁凝縮器管が、基板内の横方向通路と、それらの 通路と交差する通路が、交差する位置で基板へ取り付け られる。連結はそれらの通路の交差位置に垂直な穴を開 けることにより行われる。その後で、従来技術における ように、凝縮器管を多数の薄いひれ表面によりすべて連 結する。それから装置全体を排気し、既知の量の作動流 体を注入する。水平位置で動作させるヒートパイプ装置 では、基板内のウイックを張られている全ての通路は開 いたままにでき、それにより任意のヒートパイプ軽縮管 アンが上記論文で報告しているように、ヒートパイプと 20 への作動流体およびそれの蒸気を、他の任意のヒートパ

イブ軽縮器と蒸発器との少なくとも一方へ移動させるた めの連絡通路を設ける。斜めまたは垂直の位置で動作す ることを意図するヒートパイプ装置では、一つの通路に 対して垂直に配置されている他の涌路が、作動液体また はそれの蒸気が一つの通路から、その通路へ流れること を阻止する一連の栓により通路から分離される。蒸発器 領域内部の分離されている通路は、作動流体を拘束して より小さい領域内部に保持し、しかも作動流体が蒸発器 の内部で水平方向に移動できるようにする。したがっ

管作用により加熱領域へ戻る経縮された作動流体は、ヒ ートバイプの動作中の蒸発相および凝縮相においてより 迅速に繰り返され、それにより水平位置以外の配置にお ける用途でのヒートパイプの効率を向上させる。蒸発器 ベースから延長するヒートパイプ管へ取り付けられてい るひれ表面の上を、冷却空気が流される向きに長手方向 へ、ウイックが張られている蒸発器通路を延長されるこ とにより、ヒートパイプ装置の全体の効率が更に向上さ せられる。最後に蒸発器通路を、基板内で相互に連結さ 近くの凝縮器束の間で作動液体を移動させるための機構 40 れているが、分離される構造とすることによって、蒸発 器領域の構造強度が与えられ、それにより、付加構造支 持体なしに、ヒートパイプ組立体全体を直接固定でき、 または発熱体へ機械的に取り付けることができる。本発 明の好適な実施例においては、基板あるいは基板と固定

> を維持する。 [0008]

[実施例] この明細書においては、電子的計装装置およ ことにより、基板の熱伝達性能を大幅に向上させるもの 50 び情報処理装置に使用するための一体にされたヒートパ

板が十分に堅くて、基板の縁部のみに固定されている間

に、分布されている圧縮負荷に対して指定された平坦性

イプ熱交換器およびダンピング板用の方法および装置を 開示する。以下の説明においては、本発明を完全に理解 できるようにするために、特定の数、パワー密度、およ び熱伝達率について述べる。しかし、それらの特定の詳 細なしに本発明を実施できることが当業者には明らかで あろう。他の場合には、本発明を不必要にあいまいにし ないようにするために、周知の装置はブロック図で示

5

【0009】まず、本発明に従って製作されたヒートパ る。図2において、基板25からほぼ垂直な方向へ延長 する凝縮器管30が基板25へ連結される。基板25は それの幅方向に水平に延長するいくつかの通路27を有 する。それらの通路27は基板25の厚さの中心に全体 として配置される。通路27の内面に続結されたウイッ クが吹き付けその他の方法で付着される。尚様に、基板 25はそれの長さ方向に水平に延長するいくつかの通路 28を有する。それらの通路28は基板25の垂直方向 の垂直中間点に配置される。通路27の場合におけるよ うに、長手方向に延長する通路28へ焼結されたウイッ 20 クが付着される。そのウイックの機能は先の従来技術の 項で述べたが、以下に本発明の動作に関連して再び説明 することにする。通路27と28はほぼ垂直である。 【0010】 擬縮器管30は、図2に示すように、通路 27と28の交換位置において基板25へ取り付けられ る。各級縮器管30の内部は垂直に延長する通路29を 介して通路27、28と、流体が流れるように通じ合わ される。通路29は通路27と28の交差位置において 其板の外面20〜垂直に延長する。垂直通路29は際口 部29aを有し、その開口部の中に凝縮器管30が挿入 30 される。凝縮器管30はろう付けその他の方法で基板2 5へ適当に取り付けられ、確実な機械的接合(すなわ ち、漏れ防止) および熱的接合を行う。全ての凝縮器管 30の間を延長するいくつかの水平に延長するひれ32 が、従来技術におけるようにして取り付けられる。ひれ 32の間隔は、漕遇する特定の熱伝導状況に従って選択 できる。構造的な補強材35がこの基板25の構造的な 部分の基板25の領域の通路27、28または29を含 んでいない領域により表されている。したがって、補強 材35は「構造がない」ものと考えることができるが、40 補強材35が配置されている領域に残っている基板25 の材料が、強度およびねじれ剛性すなわちスチフネスを 増大する結果となる。補強材35の寸法は、特定の応用 のために求められる曲げスチフネスおよびねじれスチフ ネスに従って指定できる。それからヒートパイプ組立体 20全体を排気し、その後で少量の作動流体たとえば水 を、通路27、28、29と凝縮器管30により構成さ れたヒートパイプ組立体20の内部容積内へ注入する。 【0011】動作時には、ヒートパイプ組立体20の基

対流空気流が、凝縮器管30とひれ32により形成され ている垂直に延長する経緯器領域に当たる。

【0012】基板25内を2つの水平方向へ延長する互 いに直交する通路27と28のために、ただ1つの方向 の通路を用いている熱交換器の蒸発器と比較して、熱伝 適特性および等温特性が大幅に向上する結果となる。図 2に示すように、垂直に延長する任意の特定の軽縮器管 30は、交差している通路27と28を介して他の任意 の基縮器管30と流体的および熱的に接続するものと考 イブ組立体の好適な実施例が示されている図2を参照す 10 えることができる。図1に示されている従来のヒートバ イプ組立体は、蒸発器のただ1つの領域、すなわち、交 差して延長する1組の通路8へ連結されている疑縮器の 表面で凝縮するように作動流体を制約するが、本発明の 垂直に交差する通路27と28は、作動液体がどこで基 発させられたか、または最大熱束の領域がどこにあるか とは無関係に、作動流体が凝縮器構造のどこでも凝縮で きるようにする。したがって、図2に示されている本発 明のヒートパイプ組立体20は、作動流体をそれの経緯 - 蒸発ー凝縮動作サイクルで動作させる際に、相互に連 結されている凝縮器領域と蒸発器領域を完全に利用す

る。それにより小さい寸法で熱伝達効率と等温効率を向 上できる。ここで説明している好適な実施例において は、ヒートパイプ組立体20の寸法は約9×14×8cm (約3.5×5.5×3インチ) で、しかも250ワッ トを消費する。

【0013】更に、上記のように、構造補強材35によ りヒートパイプ組立体20の全体を、付加構造支持体な しに発熱体へボルトなどにより直接固定できる。とく に、標準補強材35を含んでいる基板25は、ヒートパ

イプ組立体20全体を小型電子装置における構造的固定 部材として機能させることができるように、十分に頑丈 でなければならない。本発明のヒートパイプ組立体を直 接固定できる小型電子装置の例を、 に出願さ

れた「三次元電子パッケージングのためのスタッキング ・ヒートパイプ (Stacking Heatpipe for Three-Dimensional El ectronic Packaging) ! という名称 の米国特許出願第 号に見出すことができ る。たとえば、冷却すべき豪勢体の反対側の基板25と

向き合う固定板の間に圧縮要素(すなわち、ねじ棒)を 取り付けることができる。したがって、ベースプレート 25は、ヒートパイプ組立体20のための効率的な蒸発 器として動作することに加えて、ヒートパイプ組立体を 発熱体へ固定するために必要な構造的剛性を持たせるこ とができる。熱伝導性基板に付加強度が求められる時に は、基板25は市販されている分散硬化銅で製作でき る。その分散硬化銅は小さい粒子寸法でより高い強度を 達成する。分散硬化銅の市販されている例には、アメリ カ合衆国オハイオ州クリーブランド所在のSCM特殊金

板25の底側が、ある発熱体へ密着して取り付けられ、 50 属 (SCM Speciality Metals)製

のGlidcopが含まれる。

【0014】 ここで、ヒートバイブ組立体20の単面図 と傾面図示されている図3Aと図3Bを参照する。図 3Aにおいては、水平に交差している通路27と28 が、重減に延長している通路29と交差している様子が 明らかに示されている。実に、図3Bから、ヒートバイ ブ管30が連直に延長している通路29に連結され、基 板25から重直に延長していることがかかる。

【0015】とくに、本発明のヒートパイプ装置20は 水平以外の配置で動作すべきであることがわかる。とく 10 に、ヒートバイプ組立体を取り付ける姿勢体の形状に応 じて、基板25を斜めと垂直の少なくとも一方にする必 要があることがわかる。ここで、別の好適な実施例が示 されている図4Aを参照する。図4Aにおいて、基板4 5は、水平位置で用いるようにされている図2、図3A および図3Bに示されている基板25にほぼ類似するこ とがわかる。しかし、重要なことは、図4Aに示されて いる基板45は図面上垂直に延長している通路37の中 に配置される多数の給38を有することである。給38 は水平に延長している通路36を実効的に「分離」する 20 から、図4Bに詳しく示されているように、作動流体お よびそれに関連する蒸気は、特定の水平通路36とそれ に関連する経縮器管40とで構成されている、通路37 内の1つの領域内部だけを作動流体が流されるようにさ れる。前の図に示されている基板25の場合とほぼ同様 に、凝縮器管40は基板45へ結合される。基板45へ の結合は、水平通路36と垂直通路37の交差位置で通 路39を介して行われる。図4Aと図4Bに示されてい る一体ヒートパイプ熱交換器および締め付け体の動作 は、通常のヒートパイプの機能特性に従い、作動流体 は、蒸発、凝縮、および再蒸発のサイクルをさせられ、 凝縮した作動流体は重力の作用で基板へ戻る。

86年に「計動地下に無力いたのとなか。 「0018] 図4と図4 8に示されている第2の列の 実施例においては、後38 8が作動流体が重点に延長して いる通路37の近く頃ることを阻止する。その代わり に、凝縮された作動域体は、隠迷する転縮器管40を有 する水平に延長しているそれぞれの透路36の底へ戻 る、作動域体は、水平均向に延長する検定の通路36の 内部に助約されるが、作動液体は水平方向に延長する通 第36と、隠墜する経緯器40と、凝縮器管40を水 単端路36~連接する通路39の形の全でを自由に動 平過路36~連接する通路39の形の全でを自由に動

く、要するに、作動減低は基係45の内部全体を水平に 動くが、後38の場所に応じて限られた無直領域内に基 直に制助される。基版45の製作時に総38を指定でき、金パワー、熟集、無束の場所、等な合む、物定の熱 伝達応用に従って位置させられる。あるいは、水平応 風2、図36人、図38に示されている基板25で十分で 3.5、203人、図38に示されている基板25で十分で 3.5、203人、図38に示されている基板25で十分で

【0017】図4A、図4Bに、大きい点状負荷、また は適度な分布負荷がかかる構成において、基板45のた めに曲げスチフネスを大きくする間定板 4.9 を含む第2 の別の実施例が示されている。とくに、高密度導電体、 たとえば、面積アレイ・コネクタは、電気接触ピンを2 000本まで有することができる。各ピンは、発熱体 (たとえば、MCM) が所定位置にあるときに約28. 3~56.6グラム (1~2オンス) の力を基板 45~ 加える。固定板49は基板45へ加えられる全荷重と、 非接触ピンにより起こり得る回路開放に耐えることがで きる。あるいは、固定板49の使用によって、基板45 の材料として高価な分散硬化銅の使用を避けることがで きる。それよりも、固定板49を構造要素として空偏な 鋼で製作できる。以上、電子的計装装置およびコンピュ ータ装置に使用する一体ヒートパイプ・熱交換器・締め 付け組立体について説明した。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】従来のマニホルド・ヒートパイプの構造を示す ---部切り欠き斜視図である。

【図2】本発明のヒートパイプ組立体の二次元蒸発器通路構造の斜視図を示す。

【図3】ヒートパイプ組立体の蒸発器部分の平面図と側面圏である。 【図4】本発明の第2の別の実施例の側面図と端面図と

వీరి.

#### 【符号の説明】

20、25、45 基板 27、28、29、36、37、39 通路

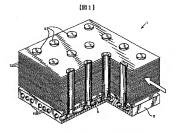
30、40 凝縮器管

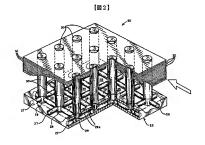
32 Oh

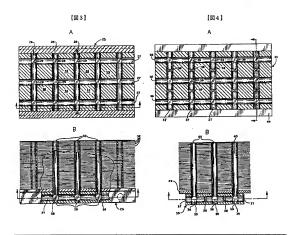
3.5 補強材

38 栓

4.9 固定板







### フロントページの続き

(72)発明者 イーサン・エッテハディ アメリカ合衆国 94706 カリフォルニア 州・アルバニイ・ピアス ストリート ナ ンバー1205・555

```
【公種種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【第門四分】第5 部門第2 区分
【発行目】平成6年(1994)8月12日
【公園番号]特開平5一264182
【公園日子収点5年(1993)10月12日
【年通号数】公園特許公電5-2642
【出版幹号)機解平5-20853
【画解特件分類第5版】
F280 15/02 L 7153-34.
H011 23/427
```

B 7220-4M

# H01L 23/46 【手統補正書】

【提出日】平成5年12月3日

【手統補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更 【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 作動流体を含む第1及び第2の複数のウ イックを張られた通路を備える蒸発器と、

蒸発した作動液体を凝縮させるために前配蒸発器へ結合 される凝縮器と、

この凝縮器により吸収された熱を移動させるために前記 擬縮器へ結合される黙交換器と、を備え、前記第10復 数のウイックを張られた通路は前記蒸発器の内部を通っ て第1の向きへ派長し、

前記第2の複数のウイックを張られた通路は前記蒸発器 の内線を通って、前記簿1の向きに対してほぼ覆直次第 2の向きへ格子状に延長するとともに前記簿1の複数の ウイックを費った通路に返達していることを参数とする 一体化されたヒートパイプ・熟交換器・締め付け組立

【請求項2】 作動流体を含む第1,第2及び第3のそれぞれ複数のウイックを張られた通路を備える蒸発器

この蒸発器のねじれ剛性と曲げスチフネスを高くするために前記蒸発器へ連結された複数の構造補強材と、 前記蒸発器から垂直に延長し、蒸発した作動流体を凝縮

前記蒸発器から垂直に延長し、蒸発した作動液体を凝縮 させるために前記蒸発器へ密封させられた複数の細長い 薄肉管と、

それらの総長い薄内管へ熟結合させられ、前記複数の線 長い薄肉管により吸収された熱を移動させる複数のひれ と、を備え、前記第1の複数のウイックを張られた通路 は前記素発露の内部を通って第1の向きへ延長し、 前記第2の複数のウイックを張られた通路は前記蒸発器

向的第2の機数のワイックを張られた連路は耐配蒸発器 の内部を通って、前配第1の向きに対してほぼ垂直な第 2の向きへ<u>格子状に</u>延長する<u>とともに前記第1の複数の</u> ウイックを張った通路に連通し、

前配第3の権数のウイックを張られた遠路は前定第1の 向きと駒記第2の向きとに対してほぼ差値な第3の向き へ横方向に延長し、複数の前記第123上び第2の適路が 交差する場所において、これと前記第123上で第2の通路と交差し、更圧複数の前記第123上で第2の通路に返 通していることを確整とする一体化されたヒートバイブ ・熱交換器・締分付け組立体、

【請求項3】 作動流体を含む第1及び第2の複数のウイックを張られた通路を備える蒸発器を用意する過程

この厳縮器により吸収された熱を移動させるために前記 凝粕器へ熱交換器を結合する過程と、を備え、前記第1 の通数のウイックを張られた通路は前記蒸発器の内部を 通って第1の向きへ延長し、

前配第2の複数のウイックを張られた通路は前配態発器 の内部を通って、前配第1の向きに対して採ば幾直次第 2の向きへ<u>格子状に延長するともに前配第1の複数の セイックを張った通路に連通していることを特徴とす</u> 五、一体化をれたヒートパイプ・熱交換器・締め付け組

立体を得る方法。

【手続補正1】 【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更 【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 作動流体を含む第1及び第2の複数のウイックを張られた通路を備える蒸発器と、

蒸発した作動流体を凝縮させるために前記蒸発器へ結合 される凝縮器と、

この凝縮器により吸収された熱を移動させるために前記

凝縮器へ結合される熱交換器と、を備え、前配第1の複 数のウイックを張られた適路は前配蒸発器の内部を通っ て第1の向きへ延長し、

前記第2の複数のウイックを振られた通路は前記蒸発器 の内部を通って、前記第1の向きに対してほぼ垂直大路 2の向きへ<u>格子状に延長するとともに前記第1の複数の クイックを張った通路に返過していることを検定する</u> 一体化されたヒートパイプ・熱交換器・締め付け超立

【請求項2】 作動流体を含む第1,第2及び第3のそれぞれ複数のウイックを張られた通路を備える蒸発器

この蒸発器のねじれ剛性と曲げスチフネスを高くするために前匹基を整へ連結された複数の構造機能はと、 前記蒸発器から垂直に延長し、蒸発した作動液体を凝縮 させるために前記蒸発器へ密封させられた複数の網長い 満肉管と

それらの細長い海内管へ熟結合させられ、前記復数の細 長い海市管により吸収された熱を移動させる複数のひれ と、管備と、前記第1の複数のウイックを張られた通路 は前記馬及器の外部を通って第1の向きへ延長し、 前記第2の複数のウイックを張られた通路は前記馬発器 の内部を通って、前記第1の向きに対してほぼ連直な第 20前きへ<u>格子式に延長するとともに前記第1の複数の</u> ウイックを張った通路に連通し、

制部第3の構敷のクイックを張られた画板は前記第1の 向きと物理第2の向きと作品では「ほぼ重度な第3の向き へ横方向に延長し、推散の前部第12±15年2つ連絡が 交差する場所において、これと前部第12±15年2の必連 節と交差し、夏に整要の前距第12±15年2の必連 適当と下いることを特徴とする一体化されたヒートバイブ 参数を発生、現場が日初かな

【請求項3】 作動流体を含む第1及び第2の複数のウ イックを張られた通路を備える蒸発器を用意する過程

蒸発した作動流体を凝縮させるために前記蒸発器へ凝縮 器を結合する過程と、

この凝縮器により吸収された熱を移動させるために前記 凝縮器へ熱交換器を結合する過程と、を備え、前記第1 の複数のウイックを張られた通路は前記蒸発器の内部を 通って第1の向きや新星し、

前配第2の複数のウイックを張られた通路は前記蒸発器 の内部を通って、前記第1の向きに対してほぼ垂直な第 2の向きへ<u>格子状に延長するとともに前記第1の複数す</u> ウイックを張った通路に連続していることを特徴とす スーケルショントレートバイブ・教育機器・終わばけお

る、一体化されたヒートパイプ・熱交換器・締め付け組立体を得る方法。